This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

庁内整理番号

(11)特許出願公開番号

特開平8-90407

(43)公開日 平成8年(1996)4月9日

(51) Int.Cl.8

識別記号

FΙ

技術表示箇所

B 2 4 B 37/04

D

Z

審査請求 未請求 請求項の数8 OL (全 5 頁)

(21)出願番号 特願平6-228062 (22)出願日 平成6年(1994)9月22日 (71)出願人 000004064

日本碍子株式会社

愛知県名古屋市瑞穂区須田町2番56号

(72)発明者 奥田 輝純

愛知県名古屋市瑞穂区須田町2番56号 日

本碍子株式会社内

(72)発明者 小口 貴司

愛知県名古屋市瑞穂区須田町2番56号 日

本碍子株式会社内

(72)発明者 野口 信愛

愛知県名古屋市瑞穂区須田町2番56号 日

本碍子株式会社内

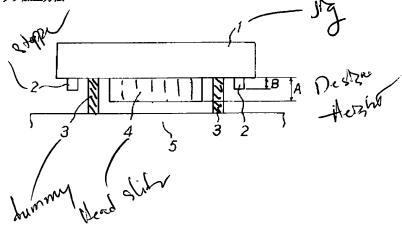
(74)代理人 弁理士 杉村 暁秀 (外5名)

(54) 【発明の名称】 ラップ治具およびそれを使用したラップ加工方法

(57)【要約】

【目的】ラップ加工で高精度の加工ができるとともに、 好ましい態様ではエッジ部のチッピングも発生しないラップ治具およびそれを使用したラップ加工方法を提供する。

【構成】加工すべきワーク4を載置する治具本体1と、治具本体1上に設けられたストッパー2および好ましい態様ではダミーワーク3とからなり、ストッパー2が治具本体1上に設けたワーク4の目標加工寸法と同一の高さを有するとともに、ダミーワーク3を設けた場合はダミーワーク3が治具本体1上に設けたワーク4の加工前高さよりも大きい高さを有するようラップ治具を構成し、このラップ治具上に加工すべきワーク4をセットし、ラップ盤5を使用してワーク4をラップ加工する。



1

【特許請求の範囲】

【請求項1】加工すべきワークを載置する治具本体と、 治具本体上に設けられたストッパーとから構成され、前 記ストッパーが前記治具本体上に設けたワークの目標加 工寸法と同一の高さを有することを特徴とするラップ治

【請求項2】前記治具本体上にワークの加工前高さより 大きい高さを有するダミーワークを設けた請求項1記載 のラップ治具。

【請求項3】前記治具本体が、前記ワークおよび/また 10 はストッパーあるいはダミーワークの治具本体上の高さ を調整するための高さ調整手段を有する請求項1または 2記載のラップ治具。

【請求項4】前記ストッパーのラップ速度が0.01μ m/分以下の材質・寸法からなる請求項1~3のいずれ か1項に記載のラップ治具。

【請求項5】前記ダミーワークのラップ速度が10 μm /分以上1000μm/分以下の材質・寸法からなる請 求項2~4のいずれか1項に記載のラップ治具。

プ治具上に加工すべきワークをセットし、ラップ盤を使 用してワークをラップ加工することを特徴とするラップ 加工方法。

【請求項7】前記ラップ加工にあたり、ダミーワークが ある場合は、まずラップ盤がダミーワークの先端に当接 してラップ加工が始まり、次ぎにダミーワークおよびワ ークをラップ加工し、ダミーワークがない場合は、ラッ プ盤がワークの先端に当接してラップ加工が始まり、最 後にラップ盤がストッパーに当接してラップ加工が終了 する請求項6記載のラップ加工方法。

【請求項8】請求項1~5のいずれか1項に記載のラッ プ治具を使用し、請求項6または7に記載のラップ加工 方法により磁気ヘッドのトラックを加工することを特徴*

> T=(ラップ前ワーク寸法A-目標ワーク寸法B)/ラップ速度 (1)

ここで、ラップ加工前ワーク寸法Aは加工前に毎回測定 する。ラップ速度は前回の加工で得られたラップ量デー タとラップ時間データとを用いて毎回計測管理が必要で ある。

[0005]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、上述し 40 たラップ盤を用いたラップ加工はコストの面で有利であ るが、以下のような課題があった。

(1) ラップ速度は加工すべきワークの材質・寸法並び にラップ治具等の荷重及びラップ盤回転数・ラップ盤面 状態・ラップ砥粒等によって決定されるが、特にラップ 盤面状態を加工中常時一定の状態に維持することが難し く、ラップ速度を常時一定に管理することが困難であ る。すなわち、当初設定したラップ速度より大きくなっ た場合は、削り過ぎによる寸法小不良となる。

【0006】(2)さらに、ラップ加工はラップ治具と※50 【0008】本発明の目的は上述した課題を解消して、

*とするラップ加工方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明はワークを高精度でラップ 加工することができるラップ治具およびそれを使用した ラップ加工方法に関し、特に磁気ヘッドのスライダーの トラック加工に好適に使用できるラップ加工治具および それを使用したラップ加工方法に関するものである。

2

[0002]

【従来の技術】従来、ワークを高精度に加工するために は、高価なスライシングマシーン等を用いる必要があっ た。例えば、図3(a)に示すように、磁気ヘッドのス ライダー31のトラック加工をする場合、図3(b)に 示すようにスライダー31のエッジ部を加工して、トラ ック幅もを例えば5μm±0.5μmと極めて高精度に 加工する必要があり、そのため、位置決め精度0.1 μ mを得ることができるクローズドループフィードバック サーボ制御機能を有する高価なNC制御スライシングマ シーンを用いて、トラック幅もが上記の範囲に入るよう 【請求項6】請求項1~5のいずれか1項に記載のラッ 20 スライダー31を高精度に加工しなければならなかっ *t*>.

> 【0003】一方、加工コストの問題を解決するため、 ワークの高精度の加工にラップ盤を用いた比較的安価な ラップ加工を用いることが考えられる。このラップ盤を 用いたラップ加工は、図4に示すように、ラップ治具4 1に載置した加工すべきワーク42をラップ盤43上に セットし、ラップ盤43を回転させた状態でラップ治具 41の自重により加工を行う定圧加工方法であり、ワー ク42の高さや幅等の寸法制御は、以下の(1)式に基 30 づき求めたラップ時間Tをタイマー等により時間管理し て行っていた。

【0004】ラップ時間T:

- ※ラップ盤との平行度を拘束・制御しない方式にて加工が 進行するため、図4において、ワーク42の左右の目標 寸法BLとBRとが厳密には同一寸法に仕上がらない、 いわゆる偏ラップと称する現象が発生する。
- (3) 図3に示したスライダー31のトラック加工等の エッジ部のラップ加工においては、ラップ加工開始時に ラップ盤とエッジ部の接触部に過大な応力が発生し、エ ッジ部にチッピングが生じることがある。

【0007】そのため、上記(1)~(3)項に示した 理由により、ラップ加工で安定的に得られるワークの寸 法精度は±1.5~2μmが限界であり高精度の加工が できないとともに、エッジ部のラップ加工はチッピング が発生し易く、その結果スライダーのトラック加工等の 高精度を必要とするワークの加工にはラップ加工を用い ることができない問題があった。

3

ラップ加工で高精度の加工ができるとともに、好ましい 態様ではエッジ部のチッピングも発生しないラップ治具 およびそれを使用したラップ加工方法を提供しようとす るものである。

[0009]

【課題を解決するための手段】本発明のラップ治具は、 加工すべきワークを載置する治具本体と、治具本体上に 設けられたストッパーとから構成され、前記ストッパー が前記治具本体上に設けたワークの目標加工寸法と同一 の高さを有することを特徴とするものである。

【0010】また、本発明のラップ加工方法は、上記構 成のラップ治具上に加工すべきワークをセットし、ラッ プ盤を使用してワークをラップ加工することを特徴とす るものである。

[0011]

【作用】上述した構成において、ストッパーは原則とし てラップ盤で加工されず、ラップ盤が回転していてもス トッパーとラップ盤とが当接した時にラップ加工の進行 を終了させることができ、従来のラップ時間Tによる制 御と比較してより高精度の加工を行うことができ、磁気 20 ヘッドスライダーのトラック加工等の高精度を要求され るワークの加工にラップ加工を適用できるようになる。 また、ダミーワークを設けた場合は、ダミーワークにワ ークの加工高さよりも大きい高さを持たせることで、ラ ップ加工開始時にはダミーワークのみが加工され、ワー クとラップ盤とが当接してワークの加工が開始される時 点でもダミーワークも同時に加工され、ワークへの加工 負荷を低減でき、チッピングのないエッジ部のラップ加 工が可能となるため、好ましい態様となる。

【0012】また、ワークおよび/またはストッパーあ 30 るいはダミーワークの高さを調整するための高さ調整手 段を設けると、特に複数個のワークを1つのラップ治具 に載置してラップ加工する場合に、ワークの高さをそれ ぞれ一致させることができるとともに、加工寸法の微調 整・変更が容易にでき、好ましい態様となる。さらに、 ストッパーの材質・寸法は特に限定するものではない が、ラップ盤によって加工されにくく一方ラップ盤に傷 がつかないものを使用することが好ましく、ラップ速度 が 0.01μ m/分以下の寸法・材質であるストッパ ー、例えば6mm×6mmの断面積を有する窒化珪素あ 40 るいは炭化珪素を使用することが望ましい。さらに、ダ ミーワークの材質についても、ラップ盤によって適当な 抵抗を持って加工される必要があり、ラップ速度が10 μm/分以上の材質・寸法を有するダミーワーク例えば 2mm×2mmの断面積を有するカーボンあるいはフェ ライト、石膏等を使用することが好ましい。

[0013]

【実施例】図1は本発明のラップ治具およびそれを使用 したラップ加工方法の一例を説明するための図である。

体、2は治具本体1上に設けた例えば窒化珪素からなる ストッパー、3は治具本体1上に設けた例えばカーボン からなるダミーワーク、4は治具本体1上に載置したワ ークである。本例ではこれら治具本体1、ストッパー2 およびダミーワーク3によりラップ治具を構成する。も ちろん、必要に応じてダミーワーク3を省くことができ る。本例では、ストッパー2の治具本体1上の高さB は、ワーク4の目標加工寸法と同一の高さとする必要が あるとともに、ダミーワーク3の治具本体1上の高さ 10 は、ワーク4の加工前高さAよりも大きい高さとする必 要がある。

【0014】上述した構成のラップ治具を使用してラッ プ加工をするには、まず図1に示すように、加工すべき ワーク4を治具本体1に載置したラップ治具を、ラップ 盤5上にセットし、ラップ盤5を一定のラップ速度で上 記(1)式で得られるラップ時間Tより長めのラップ時 間Tαの間回転させると、まずダミーワーク3がラップ 加工され、次にダミーワーク3とワーク4とが同時にラ ップ加工される。ラップ加工が進行してストッパー2の すべてがラップ盤5と接触することにより、ワーク4の ラップ加工はそれ以上進まなくなる。その結果、高精度 のラップ加工をすることができる。

【0015】なお、ワーク4および/またはストッパー 2あるいはダミーワーク3の図示しない高さ調整手段を 設けた場合は、ラップ加工、高さ測定、高さ調整(ワー ク、ストッパーまたはダミーワークの調整による)、ラ ップ加工、高さ測定・・・・を繰り返すことにより、より高 精度なラップ加工が可能となるとともに、複数個のワー クのラップ加工を同時にすることが可能となる。また、

磁気ヘッドのスライダーのトラック加工等のエッジ部の ラップ加工においては、ダミーワーク3の働きにより上 述したようにワーク4にラップ盤5が接触する際のエッ ジ部の加工負荷が低減され、チッピングのないエッジ部 のラップ加工が可能となる。

【0016】図2は本発明のラップ治具の例としてスラ イダーのトラック加工用ラップ治具の一例の構成を示す 図であり、図2(a)はその平面図を、図2(b)はそ のX-X線に沿った断面図を、図2(c)はA部詳細図 をそれぞれ示している。 図2において、 図1に示した部 材と同一の部材には同一の符号を付し、その説明を省略 する。図2に示す例は、三角形の治具本体1の各々が1 個の加工すべきワークとなるスライダー11を保持し、 これをラップ盤上にて1キャリヤに8個放射状に並べて ラップ加工することを想定している。

【0017】本例では、スライダー11のエッジ部を加 工するため、図2(c)に示すような斜めに形成された ワーク取付部12にスライダー11を載置する。ワーク 取付部12の底部には、スライダー11の取付を容易に するための溝部12aを設ける。また、ラップ加工の際 図1において、1は例えばSKD-11からなる治具本 50 の支点となる2個の支持部13を、スライダー11をは さんで設けている。支持部13の材質は、ストッパー2 と同じ材質の窒化珪素あるいは炭化珪素からなると好ま LW.

【0018】図2に示すラップ治具を使用したラップ加 工は、まずスライダー11を取り付けたラップ治具を図 示しないラップ盤上にセットする。この状態で、支持部 13とダミーワーク3とがラップ盤と接触する。ラップ 盤を所定の回転数で回転させると、支持部13はほとん ど加工されないがダミーワーク3はラップ加工される。 ジ部がラップ盤と接触するようになりスライダー11の エッジ部のラップ加工が始まる。その後さらにラップ加 工が進行して、ストッパー2がラップ盤と当接した時点 でラップ加工の進行が停止する。

【0019】図2に示す例では、ストッパー2の高さを 調整する高さ調整手段を設けている。高さ調整手段は、 図2(b)に示すように、治具本体1におけるストッパ -2の下部に設けたテーパ部14に、治具本体1に設け たネジ山15と係合させた図示しないネジとネジと係合 するピンを出し入れ可能に設けることで構成されてい る。本例では、スライダー11とストッパー2とが離れ た位置に設けられているので、てこの原理を利用でき、 例えばストッパー2の上下調整量:スライダー11のト* *ラック幅の調整量=12:1となるように、スライダー 11とストッパー2と支持部13との位置関係を設計・

製作すれば、加工すべきスライダー11の高さ方向の微 調整、すなわちトラック幅の微調整が可能となる。

【0020】上述した実施例を通じて、ストッパー2と しては、ストッパー2のラップ速度はできるだけ小さい ことが好ましいが、加工精度±0.5μmを得るために は、ラップ速度として 0.01 μm/分以下の材質・寸 法を有するストッパー、例えば6mm×6mmの断面積 ラップ加工が進行中、ある時点でスライダー11のエッ 10 を有する窒化珪素あるいは炭化珪素製ストッパーが好適 である。一方、ダイヤモンド製ストッパーはラップ速度 が極めて小さいが、ラップ盤面に傷が付き易いのに加え 高価であり好ましくなく、6mm×6mmの断面積を有 するアルミナ製ストッパーはラップ速度が1μm/分と 大きく、加工精度±0.5μmを得るためにはストッパ ー2としては好ましくない。

> 【0021】また、ダミーワーク3としては、ダミーワ ーク3もラップ速度が適切であることが必要である。ラ ップ速度の異なる寸法・材質の各種ダミーワークと図2 20 に示すラップ治具を用いて磁気ヘッドのトラック加工を 行った結果を以下の表1に示す。

[0022]

【表1】

No.	ダミー材質	ダミー寸法	ラップ速度	ダミー加工時間	チッピング	評価
1	アルミナ	3 mm × 3 mm	2 μm/ //}	50分	発生せず	×工数
2	ガラス	3 mm×3 mm	1.5μπ/分	6 6分	発生せず	×工数
3	カーポン	3 mm×3 mm	10 μ m/ 5)	10分	発生せず	0
4	カーボン	2 mm×2 mm	25 μ m/5 }	4分	発生せず	0
5	フェライト	3 mm × 3 mm	300 μ m/5 }	0.4分	発生せず	0
6	石膏	2 mm × 2 mm	1000 μ 11/分	0.1分	発生せず	0
7	石膏	0,8mm×0.8mm	4000 μ四/分	0.01分	発 生	×

注) ダミー加工代100μm

【0023】表1の結果から、ラップ速度が過度に大き いとワークとラップ盤とが衝撃的に当接するため、ワー クのエッジ部にチッピングが発生し、一方ラップ速度が 小さ過ぎると生産性が悪化する。即ち、ダミーワークの ・材質のダミーワーク、例えばカーボン、石膏あるいは フェライト等がダミーワーク3として好適であることが わかる。

[0024]

【発明の効果】以上の説明から明らかなように、本発明 によれば、ラップ治具を治具本体にストッパーを設けて 構成しているため、ストッパーは原則としてラップ盤で 加工されず、ラップ盤が回転していてもストッパーとラ ップ盤とが当接した時にラップ加工の進行を止めること ができ、ラップ時間Tによる制御と比較して高精度の加※50

※工を行うことができ、スライダーのトラック加工等の高 精度を要求されるワークの加工にラップ加工を適用でき るようになる。また、ダミーワークを使用した場合は、 ダミーワークにワークの加工高さよりも大きい高さを持 ラップ速度として10~1000μm/分を有する寸法 40 たせることで、ラップ加工開始時にはダミーワークのみ が加工され、ワークとラップ盤とが当接してワークの加 工が開始される時点でもダミーワークも同時に加工さ れ、ワークへの加工負荷を低減でき、チッピングのない エッジ部のラップ加工が可能となる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明のラップ治具およびそれを使用したラッ プ加工方法の一例を説明するための図である。

【図2】 本発明のラップ治具の例としてスライダーのト ラック加工用ラップ治具の一例を示す図である。

【図3】従来から行われているスライダーのトラック加

工を説明するための図である。

【図4】従来のラップ加工を説明するための図である。

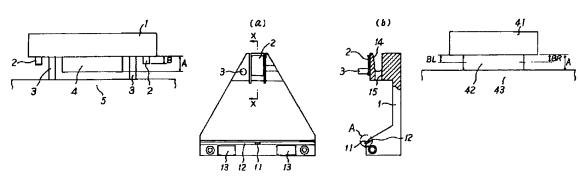
1 治具本体、2 ストッパー、3 ダミーワーク、4 ワーク、5 ラップ盤

【符号の説明】

【図1】

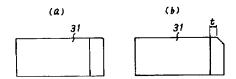
【図2】

【図4】





【図3】



DERWENT-ACC-NO: 1996-234431

DERWENT-WEEK: 199624

COPYRIGHT 1999 DERWENT INFORMATION LTD

TITLE: Lapping jig for track processing of magnetic head

slider - has stopper

provided on jig main body, to limit size and height of

workpiece to be

processed

. . . .

PATENT-ASSIGNEE: NGK INSULATORS LTD [NIGA]

PRIORITY-DATA:

1994JP-0228062 (September 22, 1994)

PATENT-FAMILY:

LANGUAGE PUB-NO PUB-DATE

PAGES MAIN-IPC

JP 08090407 A April 9, 1996 N/A

005 B24B 037/04

APPLICATION-DATA:

APPL-DESCRIPTOR APPL-NO PUB-NO

APPL-DATE

1994JP-0228062 JP08090407A N/A

September 22, 1994

INT-CL (IPC): B24B037/04

ABSTRACTED-PUB-NO: JP08090407A

BASIC-ABSTRACT:

The jig includes a jig main body (1) that loads a workpiece (4) to be

processed. A stopper (2) having a dummy workpiece (3) is provided on the jig

main body. The stopper ensures that the workpiece has

proper size and height.

ADVANTAGE - Enables accurate wrapping by stopping wrapping

when stopper and

wrapping board abut even if wrapping board rotates.

CHOSEN-DRAWING: Dwg.1/4

08/02/2002, EAST Version: 1.03.0002

DERWENT-CLASS: P61 T03

EPI-CODES: T03-A05C1A;